

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	<u>2026年3月10日</u> Point72、Valliance Asset Management、博时基金、淡水泉投资、富国基金、嘉实基金、前海开源、易方达基金等
时间	2026年3月10日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有

丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

公司披露《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》等相关公告，为满足公司业务发展的需要，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联交所上市。这是公司继 2020 年 A 股上市后，迈向国际资本市场的重要战略举措，标志着公司正式开启“A+H”双资本平台时代。此举不仅深化公司国际化战略，亦是公司依托国际资本赋能，持续提升核

	<p>心竞争力的重要布局，为公司长远高质量发展增添新动能。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司本次计划 H 股发行的融资规模大概是多少，募集资金意向使用方向有哪些？</p> <p>回复：结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，公司本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%，最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准。</p> <p>公司计划本次募集资金将主要用于关键技术及主要服务的研发投入，发展全球营销网络和生态建设，战略投资或收购，补充营运资金和一般公司用途等用途。公司此次赴港上市，将为公司核心技术研发提供资金支撑，借助资本市场赋能公司战略布局，强化核心竞争力。</p> <p>问题：当前国内 ASIC 定制芯片需求增长很快，公司如何看未来的市场前景？</p> <p>回复：近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正成为市场增长的核心驱动力。系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因，多寻求与芯片设计服务公司进行合作。</p> <p>芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂</p>

商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、微软、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业。2025 年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的收入占营业收入比重 40.36%；公司 2025 年第三季度末在手订单中来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的订单占比为 83.52%。

问题：请问公司如何看待未来自动驾驶及智能座舱芯片场景的发展空间？

回复：近年来，公司聚焦快速增长的汽车电子领域，芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务；此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。

基于上述技术布局，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

问题：近年来端侧 AI 场景需求增长，请问公司有哪些布局和客户成果？

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖数据中心、服务器等高性能云侧计算设备以及实时在线、超低能耗的端侧设备；不仅在 AI PC、AI 手机等存量市场，而且在 AI 眼镜、AI 玩具、AI Pad 等增量市场开发更先进

的核心 IP，打造更完整的芯片设计平台。

目前，公司已为某知名新能源汽车厂商提供全球领先的基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，实现一次流片成功，并且正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案。针对快速发展的 AI 端侧应用，芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP；其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为 AI 眼镜等“始终在线”、超低能耗、超轻量可穿戴设备、AI Pad、AI 玩具等提供端侧 AI ASIC 的解决方案。